

2007—2008年中国半导体行业薪酬福利研究年度报告

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《2007—2008年中国半导体行业薪酬福利研究年度报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/xiantiyongpin/2949329493.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：15000元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

研究领域：半导体行业涉及厂商：Intel、三星、TI、MEMC、三洋、华虹NEC、中环等。报告推荐2007年，开展了ICT领域的薪酬调查活动。通过邀请企业参加薪酬调查、深入企业现场、访谈企业员工，以及充分利用举办的各行业年度会议和论坛进行问卷调查，搜集整理了数百家企业的各职能领域和各层级员工的薪酬数据。面对人才市场的竞争与人力资源管理的困惑，发布的《2007—2008年中国半导体行业薪酬福利研究年度报告》，帮助半导体行业内企业准确了解市场的薪酬福利信息，为企业人力资源管理的薪酬决策提供最有价值的参考——&

从半导体行业发展的状况及趋势分析着手，深入分析了行业人才流动性与供需状况。&归纳总结了半导体行业的薪酬福利特点、薪酬激励体系应用情况，为企业制定薪酬政策提供可以借鉴的建议和指导。&通过对半导体行业内典型企业岗位的梳理，按照企业的性质，结合岗位任职人员的条件，详细地描述了每一个岗位的职业条件、职责内容、薪酬结构、收入水平、薪酬组成情况及各项福利。&另外，针对影响半导体行业薪酬的多个重要因素、薪酬管理的重点、薪酬福利的趋势，为企业薪酬管理变革提供了相应的建议 and 操作方法。报告框架目录调研总结与说明主要结论重要发现一、半导体行业发展综述(一)

半导体行业发展水平1、半导体行业发展现状2、半导体行业发展趋势(二)半导体行业人才流动性与供需状况分析1、流动性分析2、供需状况分析二、半导体行业薪酬福利体系(一)

半导体行业薪酬特点(二)半导体行业薪酬激励体系应用状况分析三、半导体行业企业岗位体系(一)半导体行业企业管理组织架构分析1、组织结构特点2、组织结构变革趋势(二)

半导体行业企业岗位体系设置(三)半导体行业企业重点岗位薪酬福利特点1、管理岗位2、技术岗位3、销售岗位4、策划岗位5、……四、半导体行业重点岗位薪酬福利状况(一) CEO1

、职位条件及描述2、薪酬结构3、薪酬收入水平4、福利水平5、公司类型与个人条件结合综合分析(二) 人力资源总监1、职位条件及描述2、薪酬结构3、薪酬收入水平4、福利水平5

、公司类型与个人条件结合综合分析(三)……五、半导体行业薪酬福利发展趋势(一) 影响薪酬变化的因素1、内部因素2、外部因素(二)半导体行业薪酬福利管理重点1、岗位价值评估2

、薪酬策略制定(三) 半导体行业薪酬福利趋势1、薪酬管理趋势2、福利政策趋势

六、建议主要结论表目录 2003—2007年中国半导体市场整体规模与增长状况

2008年半导体行业薪酬管理趋势状况 2008年半导体行业福利政策趋势状况……图目录

2003—2007年中国半导体市场整体规模与增长 2007年半导体行业的CEO薪酬收入水平

2007年半导体行业的人力资源总监薪酬收入水平……

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xiantiyongpin/2949329493.html>